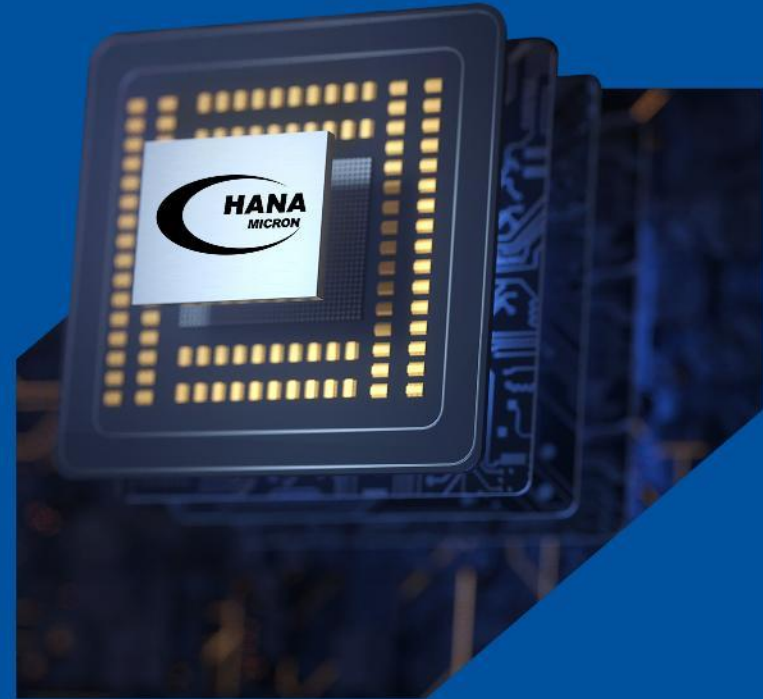


INVESTOR RELATIONS 2026

# INNOVATIVE SEMICONDUCTOR SOLUTION PROVIDER

고객의 Needs에 맞는 최적의 솔루션을 찾아 제안합니다.



Investor Relations 2026

# Table of Contents

- 01. Business Overview
- 02. 1Q26 실적 (연결)
- 03. 1Q26 법인별 실적
- Appendix



## DISCLAIMER

본 자료는 투자자를 대상으로 실시되는 presentation에서 정보를 제공하기 위한 목적으로 하나마이크론(이하 “회사”)이 작성한 것이며 본 자료를 복사, 재생, 배포 또는 게재하거나 다른 목적으로 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 본 presentation에 참석하는 경우 위 내용에 대한 동의로 간주되며 만일 위 사항을 위반하는 경우 동시에 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’의 위반에도 해당 될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별적인 확인 절차를 거치지 않은 정보입니다. 이는 과거가 아니라 향후 예상되는 미래의 회사 경영현황 및 재무실적을 의미하는 것으로서, ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어가 사용된 경우는 “예측정보”를 가리킵니다.

“예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 영향을 받을 수 밖에 없어 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제의 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 presentation 실시일 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려하여 작성된 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 투자자에 대한 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다.

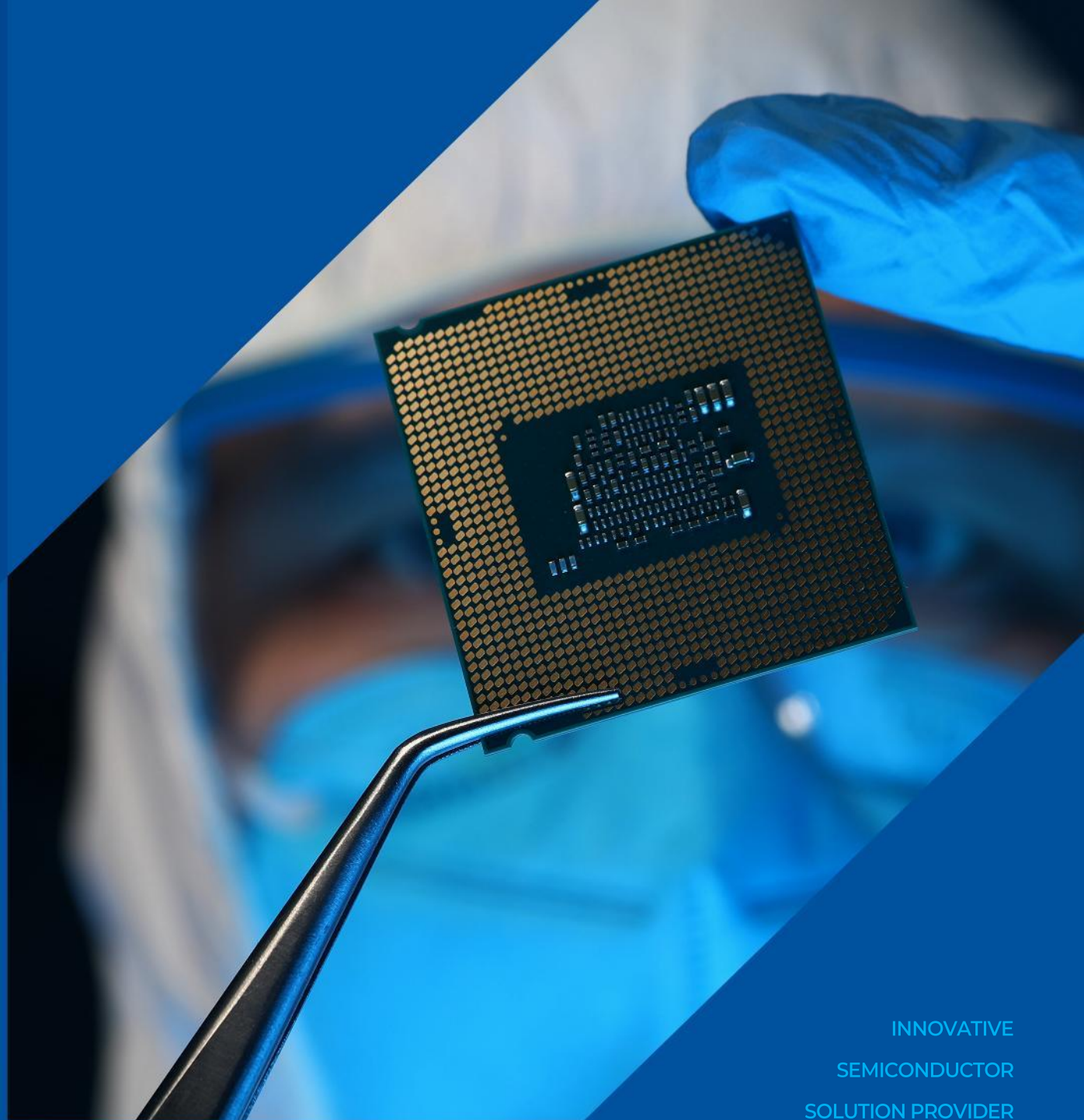
**본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 과실 등의 여부를 불문하고 여하한 책임도 부담하지 아니합니다. 본 자료는 주식의 모집 또는 매매의 청약에 대한 권유에 해당되지 아니합니다.**



# 01

## Business Overview

1. Company Overview
2. Value Chain
3. Business Area
4. Major Affiliates



INNOVATIVE  
SEMICONDUCTOR  
SOLUTION PROVIDER

# 1. Company Overview



## 반도체 후공정 패키징 및 테스트 전문기업



### 최창호 회장

2001.08 ~ 2017.03  
 하나마이크론 대표이사  
 1999.08 ~ 2001.05  
 삼성전자 멕시코 복합단지장  
 1995.12 ~ 1998.07  
 삼성전자 반도체 관리본부장  
 1987.11 ~ 1992.03  
 삼성반도체 관리이사



### 이동철 대표이사

2019.03 ~ 현재  
 하나마이크론 대표이사  
 2015.03 ~ 2018.12  
 삼성SDI 기획팀장, 구매팀장  
 2012.01 ~ 2014.12  
 SMD 기획팀장  
 1984.12 ~ 2011.12  
 삼성전자 (SEJ 반도체 사업부장 外)

### General Description

회사명	하나마이크론
대표이사	이동철
설립일	2001년 8월 23일
자본금	332억원 (2025년 12월 말)
매출액	15,344억원 (2025년 연결기준)
임직원수	771명 (2025년 12월 말)
사업영역	반도체 패키징 및 테스트
소재지	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 본사 : 충청남도 아산시 음봉면 연암울금로 77</li> <li>• 판교 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35</li> <li>• 미국법인 : 1900 McCarthy Blvd. #210 Milpitas, CA95035, U.S.A &lt;HMA&gt;</li> </ul>

# 2. Value Chain



## 종합반도체회사 (IDM : Integrated Device Manufacturer)



### Fabless (Design)



### Foundry (가공)



### Packaging&Test



Full Turnkey  
OSAT Service



메모리, 비메모리  
in Brazil

### Module Ass'y&Test



모듈 조립/테스트  
외주서비스  
In Vietnam



자사 모듈 생산/판매  
In Brazil

\* OSAT – Outsourced Semiconductor Assembly & Test

# 3. Business Area



## 풀 턴키(Full Turnkey) OSAT 서비스

Bump	Wafer Test	Assembly	Final Test	Module @ 해외법인
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solder plate</li> <li>• Ball Drop</li> <li>• Cu Pillar</li> <li>• Thick RDL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wafer Test (Probe Test)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wire Bonding</li> <li>• Flip Chip / BGA/ FBGA</li> <li>• WLP</li> <li>• Flexible PKG</li> <li>• SiP, SoC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Test</li> <li>• SOC Test</li> <li>• Logic Test</li> <li>• Analog Test</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module Assembly (SMT)</li> <li>• Elec Test</li> <li>• Application Test</li> </ul>

### Customer



# 4. Major Affiliates



## 반도체 후공정 기반의 글로벌 사업 전개

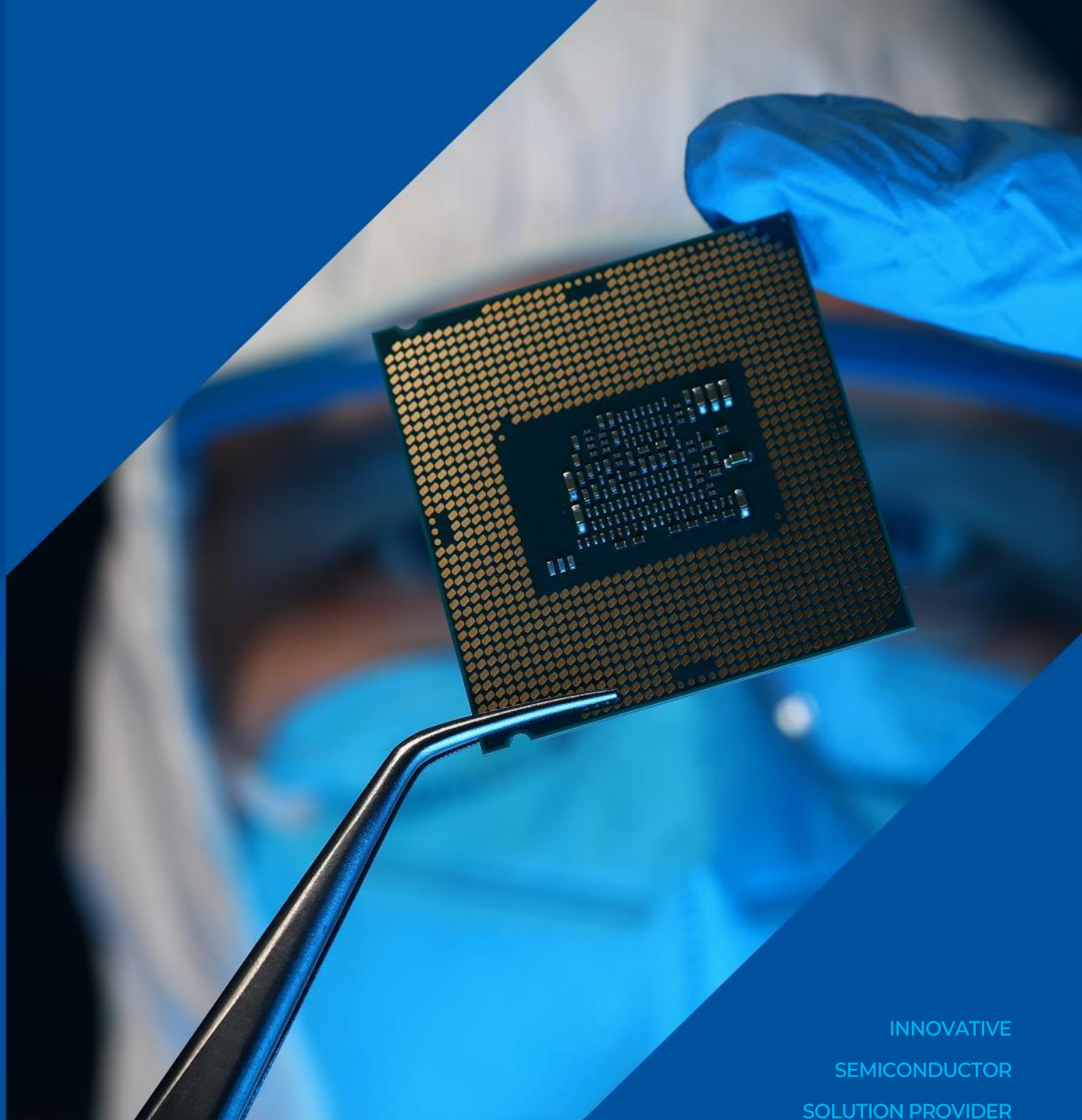
회사명	하나마이크론	하나더블유엘에스	HANA Micron Vina	HANA Micron Vietnam	HT Micron	HANA Electronics	하나머티리얼즈
사업 부문	반도체 후공정 임가공				반도체 제조 및 판매(브랜드)		반도체 소재부품
위치	한국		베트남		브라질		한국
제품군	메모리, 비메모리	비메모리	메모리	비메모리	메모리	메모리	실리콘 부품
주요 고객	SEC, Fabless	Fabless	SK Hynix	Fabless	SEC	SEC, DELL	TEL
보유 공정	Package Final Test	Bump Probe Test	Package Final Test Module	Package	Package Final Test	Module	-



# 02

## 1Q26 실적 (연결)

1. 경영실적
2. 주요 매출처
3. 제품별 비중



INNOVATIVE  
SEMICONDUCTOR  
SOLUTION PROVIDER

# 1. 경영실적 (연결)

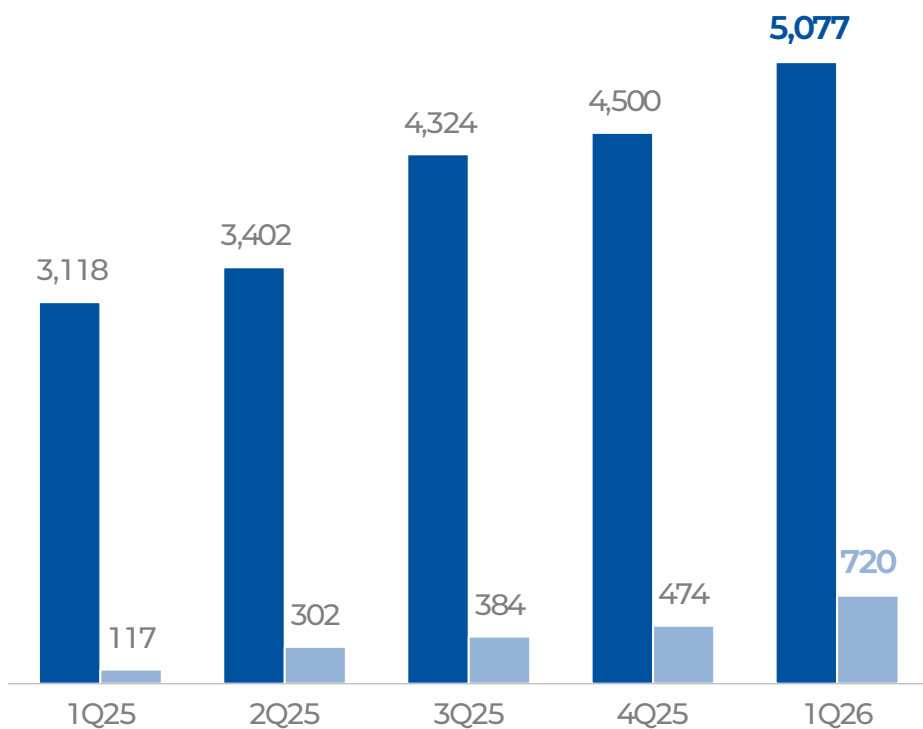


## 2026년 1분기 전년동기비 연결기준 매출액 63%, 영업이익 515% 성장

### 경영실적(연결)

단위: 억 원

■ 매출액 ■ 영업이익



주: K-IFRS 연결 기준

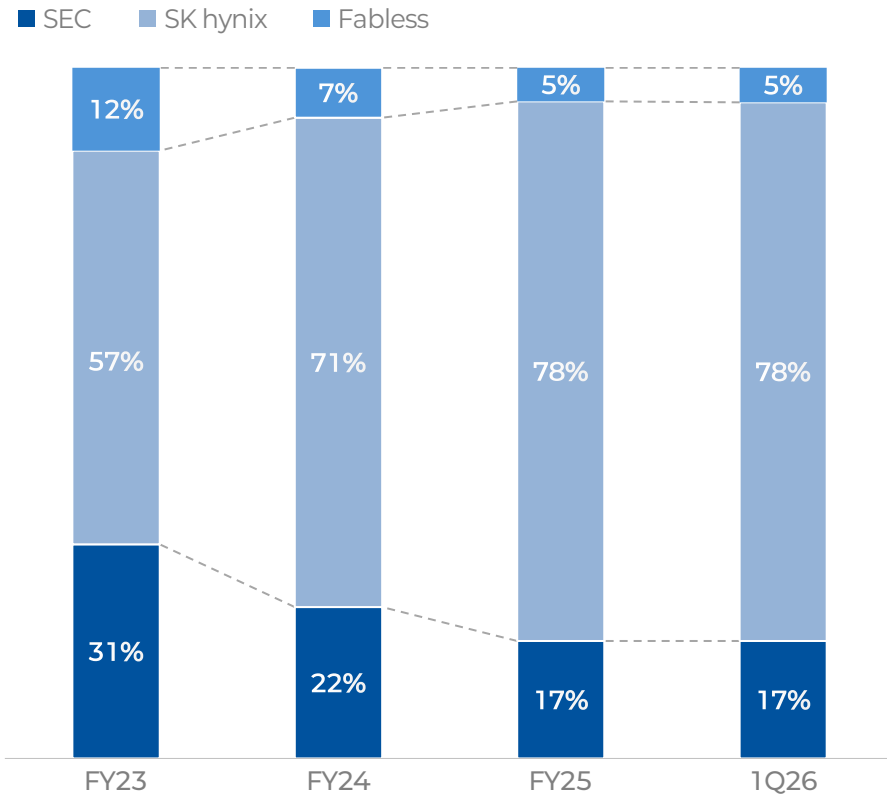
단위: 억 원, %	1Q26	1Q25	YoY	4Q25	QoQ
매출액	5,077	3,118	+62.8	4,500	+12.8
매출총이익	1,012	336	+201	679	+49.0
(%)	19.9	10.8	+9.1%p	15.1	+4.8%p
영업이익	720	117	+515	474	+51.9
(%)	14.2	3.8	+10.4%p	10.5	+3.7%p
당기순이익	728	6	+12,033	361	+102
(%)	14.3	0.2	+14.1%p	8.0	+6.3%p

## 2. 주요 매출처 (연결)



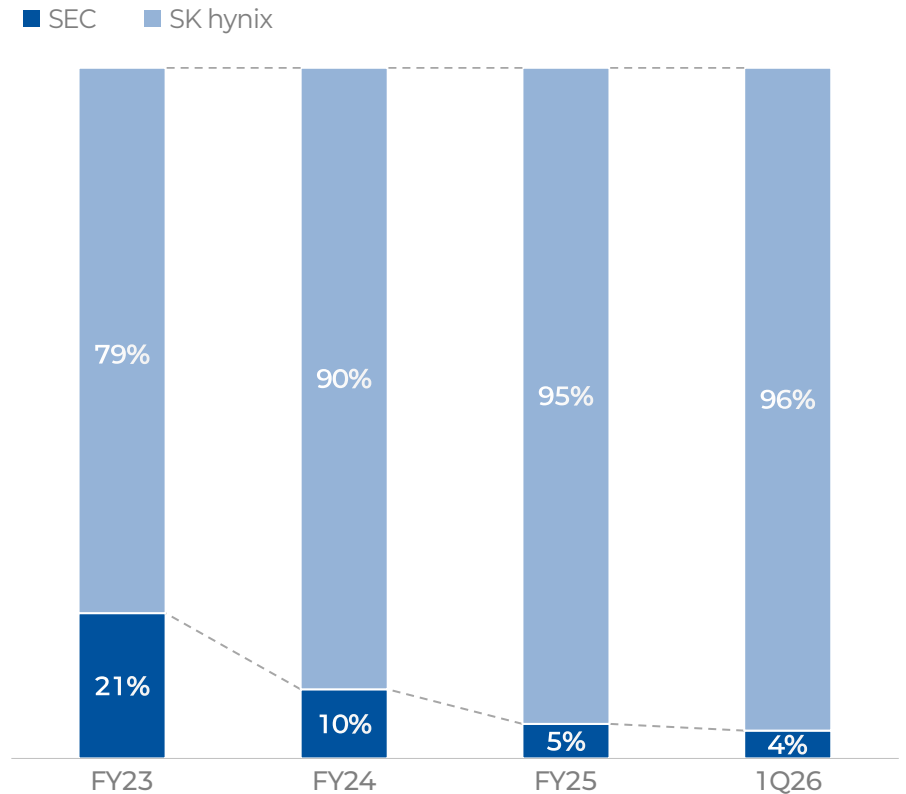
### 삼성전자, SK하이닉스, 팹리스 등 다양한 고객사 확보

#### 주요 매출처 비중



주: 본사 및 베트남 법인 기준

#### 메모리 반도체 고객사별 매출액 비중



주: 본사 및 베트남 법인 기준

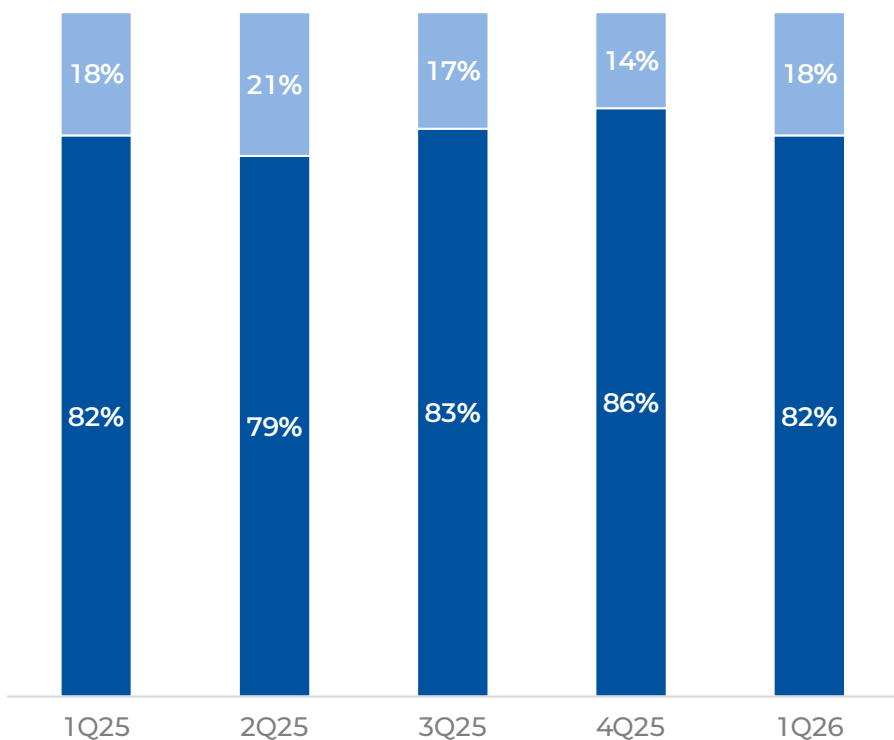
### 3. 제품별 비중 (연결)



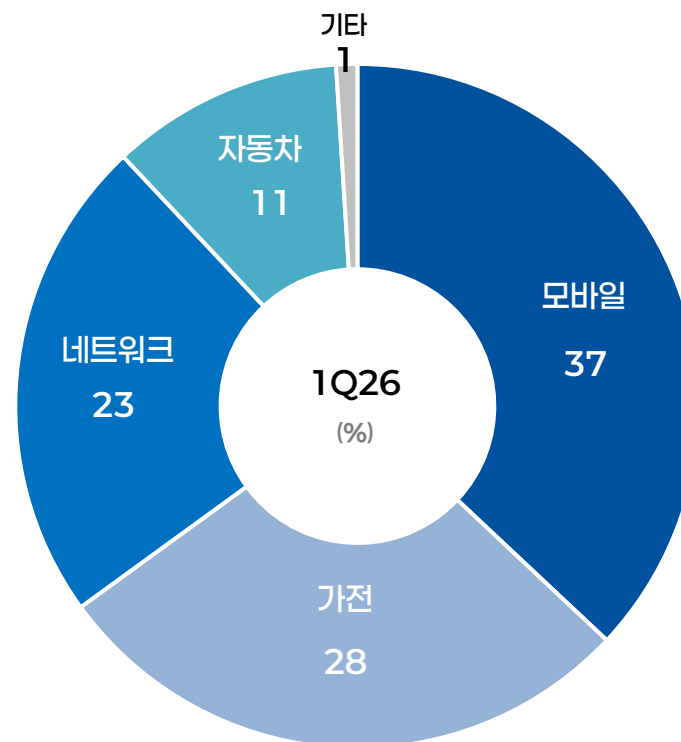
## 비메모리 반도체 제품 다변화 통한 성장 확대

#### 메모리/비메모리 반도체 매출 비중

■ 메모리 ■ 비메모리



#### 비메모리 반도체 제품별 매출 비중



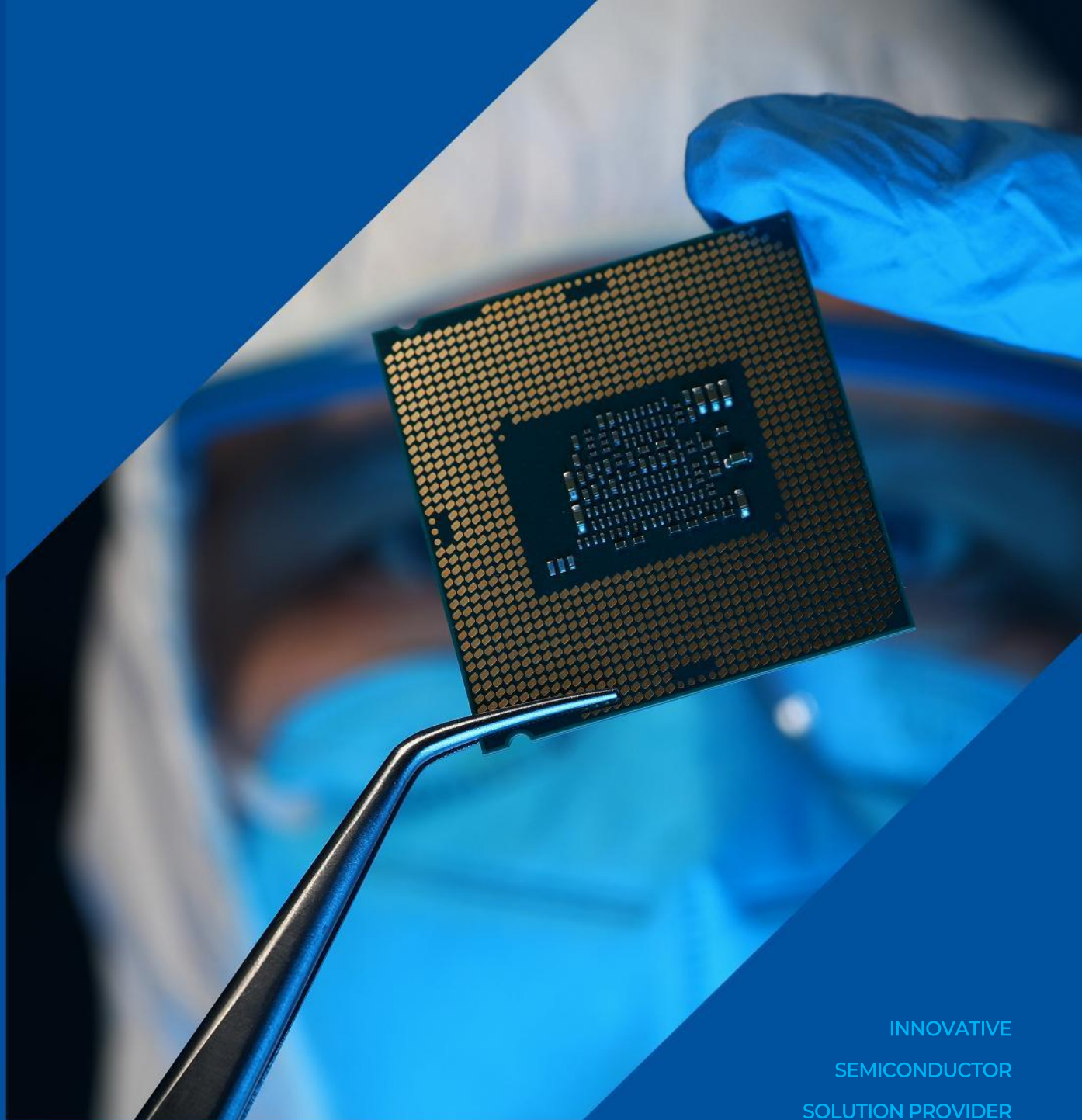
주: 본사 및 베트남 법인 기준



# 03

## 1Q26 법인별 실적

1. 법인별 경영실적\_본사
2. 법인별 경영실적\_베트남
3. 법인별 경영실적\_브라질
4. 하나머티리얼즈 경영실적



INNOVATIVE  
SEMICONDUCTOR  
SOLUTION PROVIDER

# 1. 법인별 경영실적\_본사

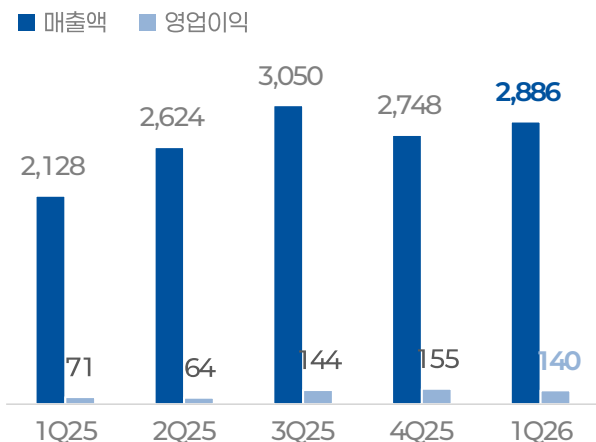


## 메모리 사업 점진적 회복 및 비메모리 사업 지속 성장

- 1Q26 별도 기준 YoY 매출액 35%, 영업이익 97% 증가
- 비메모리 반도체 실적 지속 증가: Automotive向 Large Body 등 고부가가치 비메모리 반도체 확대
- 1Q26 테스트 공정 가동률 75%: 연간 테스트 사업 부문 매출 역대 최고 실적 달성 기대
- 2Q26 패키징 공정 생산능력(CAPA) 증대: 하반기 비메모리 패키징 부문 매출 성장 확대 전망

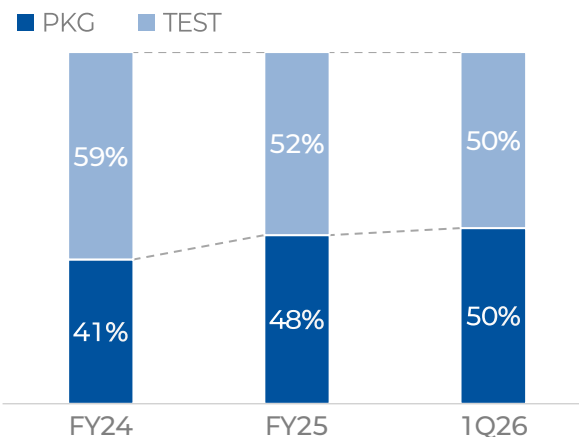
### 경영실적(별도)

단위: 억 원

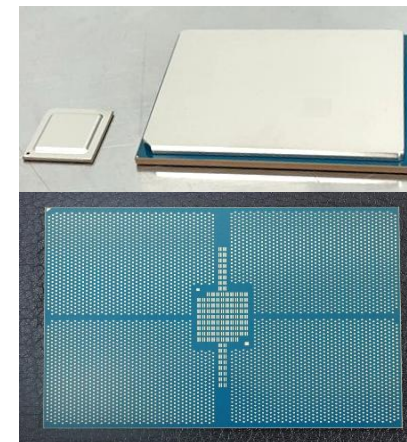


주: K-IFRS 별도 기준

### 비메모리 반도체 공정별 매출 비중



### Large Body 양산 (58\*75mm)



## 2. 법인별 경영실적\_베트남

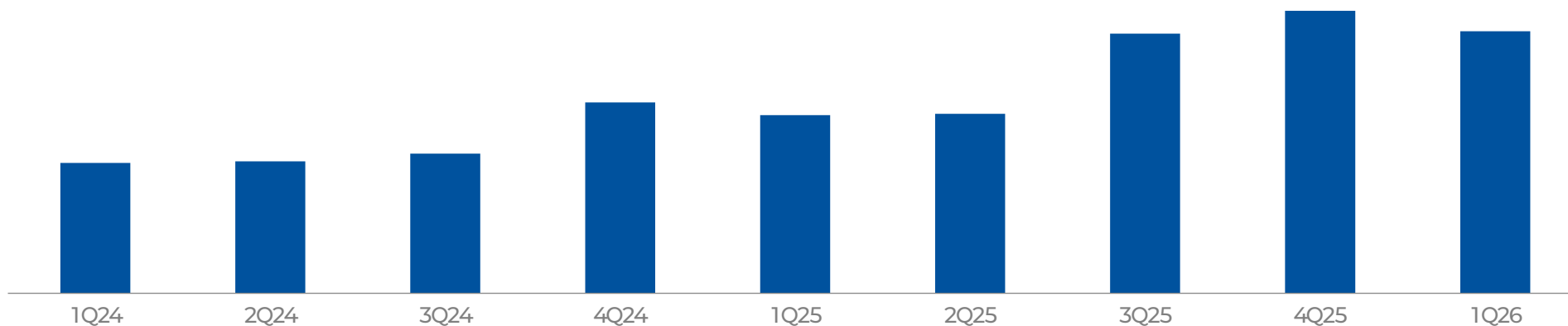


### 글로벌 반도체 슈퍼사이클 진입에 따른 지속적인 매출 성장

- [박장] 데이터센터 확대 등으로 1Q26 D램(DRAM) 생산량 중 서버向 제품의 생산 비중 확대  
 글로벌 낸드 플래쉬(NAND Flash) 수요 증가에 따라 SSD 생산량 1Q26 전체 생산량 대비 약 30% 비중 차지  
 소규모 장비 투자 통해 3Q26 이후 생산능력(Capa) 확대 전망
- [박닌] 클린룸 확장 및 비메모리 반도체 생산량 확대 진행 중

#### 분기별 매출액 (2024년~2026년)

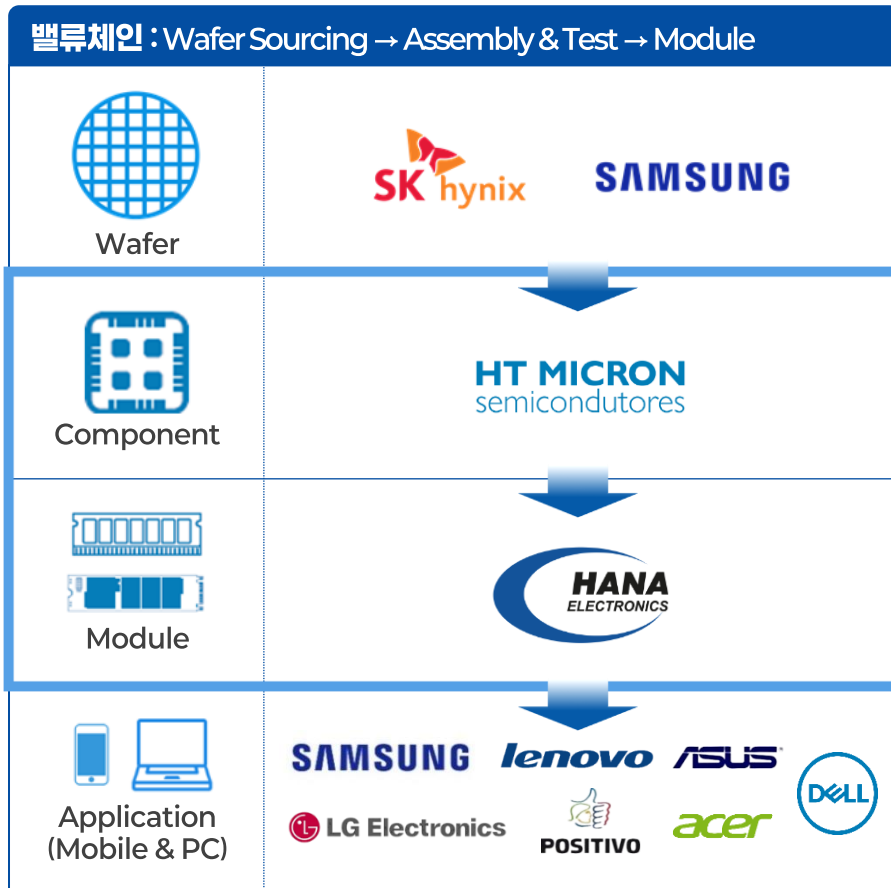
단위: 억 원



### 3. 법인별 경영실적\_브라질

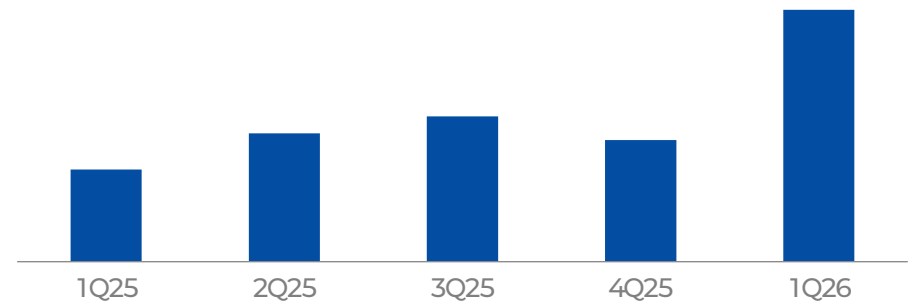


## 메모리 반도체 수요 확대 및 고객사 다변화를 통한 수익성 증대



### 브라질 법인 매출액

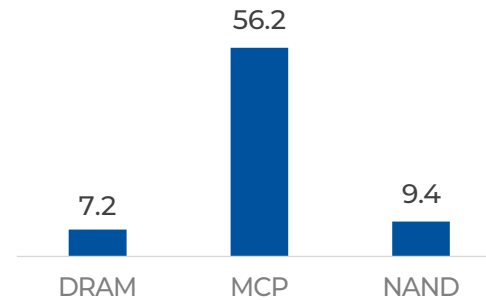
단위: 억 원



### 브라질 법인 연간 Capa

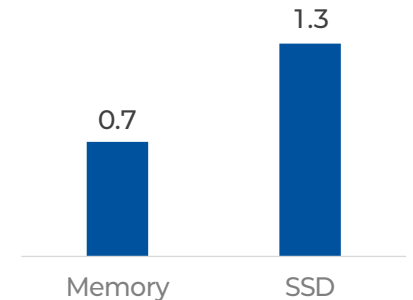
#### HT Micron

단위: 백만 개 (칩)



#### Hana Electronics

단위: 백만 개 (모듈)



· PPB: 현지 생산 인센티브 적용을 위한 필수 제조 기준  
 · PADIS: 반도체 및 디스플레이 업종 전용 조세 감면 프로그램

## 4. 하나머티리얼즈 경영실적

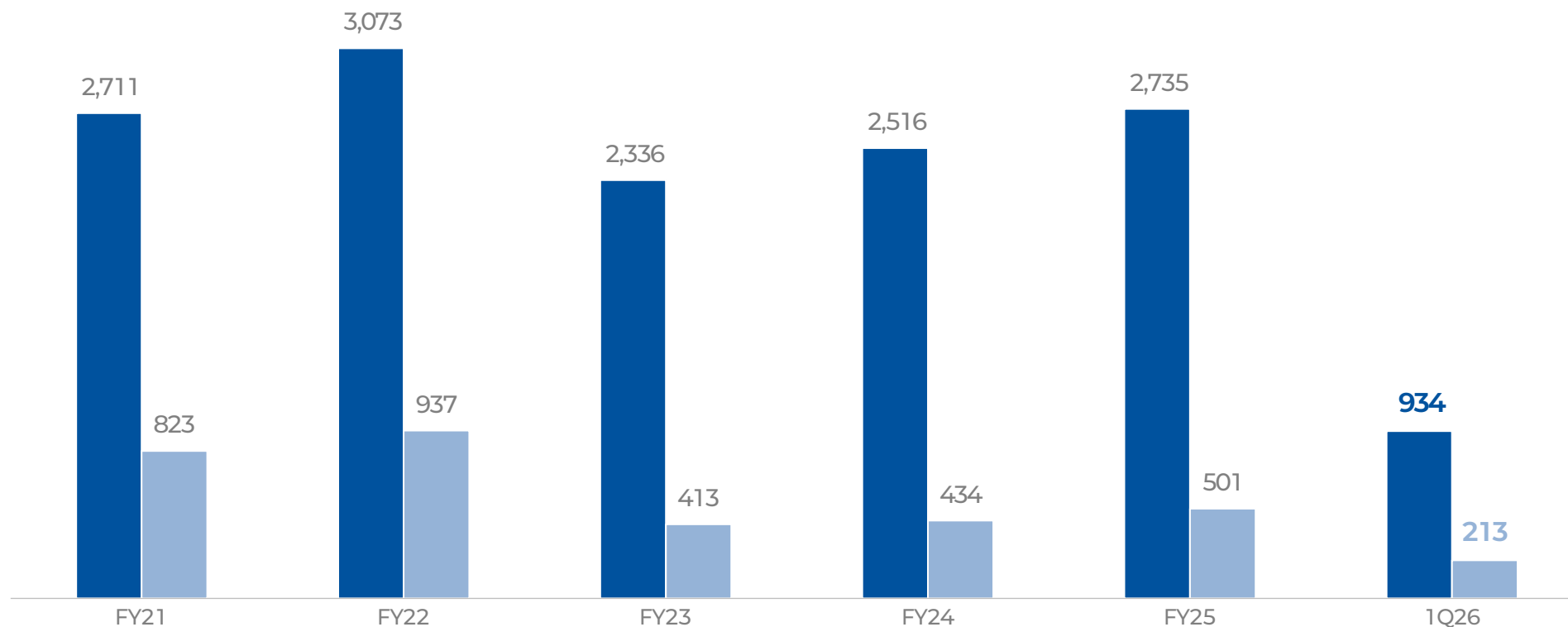


### 글로벌 반도체 생산 확대에 따른 지속 성장 기대

#### 하나머티리얼즈 경영 실적

단위: 억 원

■ 매출액 ■ 영업이익



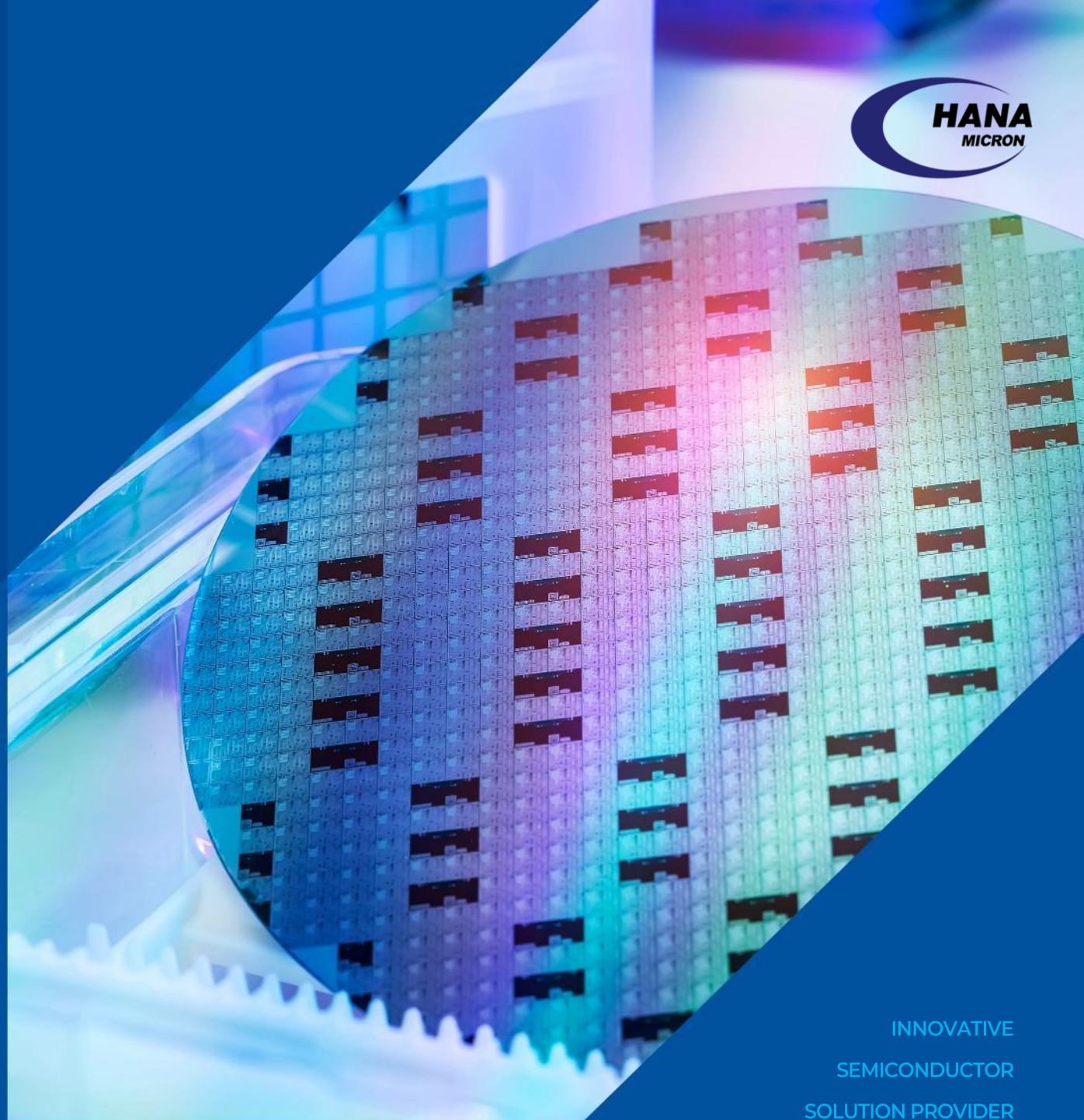
주: K-IFRS 연결 기준



---

## Appendix

1. 요약재무제표 (연결)
2. 요약재무제표 (별도)
3. Infrastructure
4. Market Trends



INNOVATIVE  
SEMICONDUCTOR  
SOLUTION PROVIDER

# 1. 요약재무제표 (연결)



## 연결재무상태표

단위: 억 원

구분	FY23	FY24	FY25	1Q26
유동자산	4,316	6,155	7,005	8,143
비유동자산	12,935	13,291	13,173	13,505
<b>자산총계</b>	<b>17,251</b>	<b>19,446</b>	<b>20,178</b>	<b>21,648</b>
유동부채	6,447	6,202	8,271	9,512
비유동부채	5,360	7,186	5,380	4,809
<b>부채총계</b>	<b>11,807</b>	<b>13,388</b>	<b>13,651</b>	<b>14,321</b>
지배기업소유주지분	3,091	3,716	3,988	4,712
자본금	240	331	332	332
기타불입자본	1,944	2,637	2,436	2,143
기타자본구성요소	305	427	358	508
이익잉여금	602	320	862	1,729
비지배지분	2,353	2,342	2,539	2,615
<b>자본총계</b>	<b>5,444</b>	<b>6,058</b>	<b>6,527</b>	<b>7,327</b>

주: K-IFRS 연결 기준

## 연결손익계산서

단위: 억 원

구분	FY23	FY24	FY25	1Q26
매출액	9,679	12,507	15,344	5,077
매출원가	8,410	10,605	13,221	4,065
매출총이익	1,269	1,902	2,123	1,012
판매비와관리비	690	834	846	292
영업이익	579	1,068	1,277	720
기타영업외손익	(167)	(45)	125	228
금융손익	(272)	(1,041)	(609)	(142)
지분법손익	(0)	(2)	7	16
법인세비용차감전 순이익	140	(20)	800	822
당기순이익	10	(112)	656	728
지배기업소유주지분	(135)	(238)	381	610

주: K-IFRS 연결 기준

## 2. 요약재무제표 (별도)



### 별도재무상태표

단위: 억 원

구분	FY23	FY24	FY25	1Q26
유동자산	2,515	2,562	4,100	4,001
비유동자산	7,317	7,692	7,288	7,885
<b>자산총계</b>	<b>9,832</b>	<b>10,254</b>	<b>11,388</b>	<b>11,886</b>
유동부채	4,535	3,407	5,213	5,402
비유동부채	1,566	2,539	1,526	1,041
<b>부채총계</b>	<b>6,101</b>	<b>5,946</b>	<b>6,739</b>	<b>6,443</b>
자본금	240	331	332	332
기타불입자본	2,669	3,359	3,169	2,877
기타자본구성요소	168	211	191	404
이익잉여금(결손금)	654	407	956	1,830
<b>자본총계</b>	<b>3,731</b>	<b>4,308</b>	<b>4,469</b>	<b>5,443</b>

주: K-IFRS 별도 기준

### 별도손익계산서

단위: 억 원

구분	FY23	FY24	FY25	1Q26
매출액	5,819	7,976	10,550	2,886
매출원가	5,454	7,526	9,904	2,696
매출총이익	365	450	646	190
판매비외관리비	198	218	212	50
영업이익	167	232	434	140
기타영업외손익	2	322	95	134
금융손익	(35)	(555)	(111)	(43)
지분법손익	(499)	(215)	(4)	420
법인세비용차감전 순이익	(365)	(216)	414	651
당기순이익	(430)	(207)	401	622

주: K-IFRS 별도 기준

# 3. Infrastructure



## 글로벌 패키징, 테스트 시설 인프라 구축

### 대한민국



- 위치: 충청남도 아산
- 면적: 15,000평
- 주요 제품: 모바일, 가전, 차량, 네트워크
- 주요 고객사: 삼성전자, 팹리스 등

### 브라질



- 위치: 브라질 상레오폴두
- 면적: 3,000평
- 주요 제품: PC, 모바일, 가전
- 주요 고객사: 삼성전자, 레노버 등

### 브라질



- 위치: 브라질 마나우스
- 면적: 400평
- 주요 제품: PC, 모바일
- 주요 고객사: 삼성전자, Dell 등

### 베트남



- 위치: 베트남 박닌성
- 면적: 2,500평
- 주요 제품: 비메모리 반도체
- 주요 고객사: Microchip, Egis 등



- 위치: 베트남 박닌성
- 면적: 20,000평
- 주요 제품: 메모리 반도체 전 제품
- 주요 고객사: SK하이닉스

# 4. Market Trends



## 반도체 패키징 중요성 증가에 따른 OSAT 수요 확대

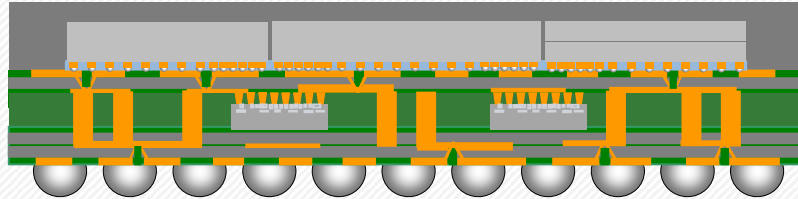


# [참고자료] Advanced 2.5 Semiconductor Packaging



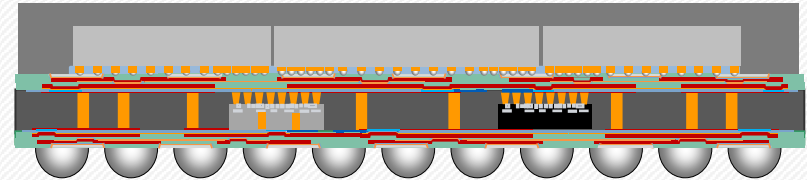
- HIC™ (Heterogeneous Integrated Chip) technology enables advanced 2.5D structures.
- It utilizes High IO Density Bridge for long range routing and Advanced Fan Out PKG for short range routing.
- HIC suits for chiplet-based system integration especially in AI applications.

Intel EMIB



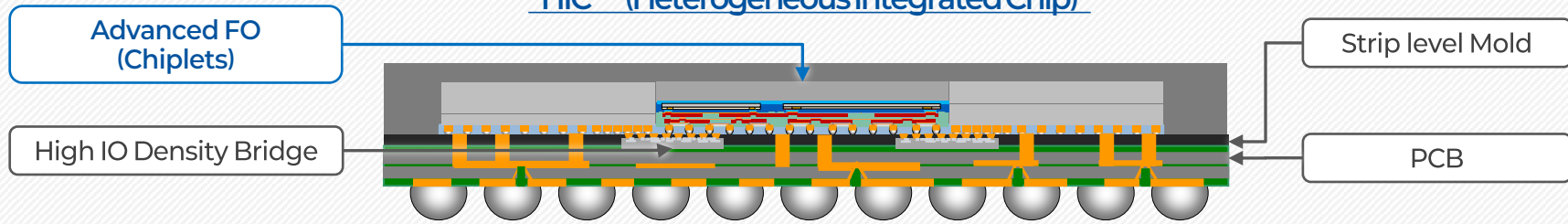
Key Tech Si bridge embedded PCB

TSMC LSI / ASE FOCoS  
SPIL FOEB / Amkor S-Connect



Key Tech Si(w/TSV)&Molded bridge, Double side RDL

“HIC™ (Heterogeneous Integrated Chip)”





# Thank you

## 하나마이크론(주)

---

충청남도 아산시 음봉면 연암울금로 77  
(T) 041-423-7777 (아산)  
031-698-9009 (판교 R&D센터)



INNOVATIVE  
SEMICONDUCTOR  
SOLUTION PROVIDER